

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 19 年 12 月 20 日 (2007.12.20)

【公開番号】特開 2005-142572 (P2005-142572A)

【公開日】平成 17 年 6 月 2 日 (2005.6.2)

【年通号数】公開・登録公報 2005-021

【出願番号】特願 2004-322683 (P2004-322683)

【国際特許分類】

H 0 5 K 1/03 (2006.01)

C 0 8 K 3/00 (2006.01)

C 0 8 L 27/12 (2006.01)

C 0 8 L 79/08 (2006.01)

H 0 1 L 21/60 (2006.01)

【F I】

H 0 5 K 1/03 6 1 0 N

H 0 5 K 1/03 6 1 0 S

C 0 8 K 3/00

C 0 8 L 27/12

C 0 8 L 79/08 A

H 0 1 L 21/60 3 1 1 W

【手続補正書】

【提出日】平成 19 年 11 月 2 日 (2007.11.2)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

単独でまたは多層構造の成分として電子用途または電気用途に有用である単一層基板であって、単一層基板は少なくともポリイミド成分およびフルオロポリマー成分のポリマーブレンドを含み、

a. フルオロポリマー成分は、

i. 0.02 ミクロンと 5 ミクロンの間の範囲内（両端を含む）の平均粒径を有するフルオロポリマー微細粉末から誘導され、

ii. 375 以下の融解温度を有し、

iii. フルオロポリマー成分は、100 重量部のポリイミド成分当たり、9 および 120 重量部の間の範囲内（両端を含む）で存在し、

b. 単一層基板は外側表面と内部コアとを有し、外側表面は、内部コア中に存在するフルオロポリマー成分の量よりも多い量のフルオロポリマー成分を含み、内部コアは、外側表面中に存在するポリイミド成分の量よりも多い量のポリイミド成分を含み、

c. 10 ミクロンと 200 ミクロンの間の範囲内（両端を含む）の総厚を有することを特徴とする単一層基板。